

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2023-059

芯原微电子（上海）股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“本公司、公司、芯原股份”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了截至2023年9月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告，报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1537号）以及上海证券交易所出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2020]261号），芯原微电子（上海）股份有限公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）48,319,289股，每股发行价格为38.53元，募集资金总额为186,174.22万元，扣除发行费用18,378.91万元后，募集资金净额为167,795.31万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月13日出具《验资报告》（天职业字[2020]32075号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放和管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，制定了《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金

管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该管理办法已经公司股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司及子公司芯原科技（上海）有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“开户行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2023年9月30日，上述监管协议履行正常。

截至2023年9月30日，公司前次募集资金在银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	初始存放余额	2023年9月30日 账户余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600002036	1,699,030,248.80	4,639,033.75	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003720	-	42,372,393.98	
中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行	1001235929300088184	-	2,931,557.44	
中信银行股份有限公司海分行张江支行	8110201013701212254	-	-（注1）	已销户（注2）
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910739810105	-	-（注1）	已销户（注3）
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03004198987	-	-（注1）	已销户（注3）
总计	/	1,699,030,248.80	49,942,985.17	

注 1：相关账户分别为公司“智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目”、“智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台项目”、“智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目”、“研发中心升级项目”的募集资金专户，上述项目已于 2022 年度完成。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定已将节余募集资金（包括利息收入）转出并补充流动资金。

注 2：公司“智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目”账户于 2022 年 12 月 20 日已销户。

注 3：公司“智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台项目”、“智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目”、“研发中心升级项目”账户分别于 2023 年 2 月 16 日和 2023 年 2 月 28 日已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告“附表 1：前次募集资金使用情况对照表”。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目全部用于研发投入、科技创新和新服务开发提供，主要为公司的半导体 IP 应用方案和系统级芯片定制平台类项目、研发中心新建或升级项目及永久补充流动资金项目。

公司半导体 IP 应用方案和系统级芯片定制平台相关募投项目的实施，有助于公司的 IP 定制化服务从原有的针对个别产品、点对点服务单一客户，逐步拓展为可广泛适用于某一客户所在行业的全体客户，以实现公司更加快速地响应客户定制化需求，更加高效地提供行业应用解决方案。

“研发中心升级项目”及“研发中心建设项目”作为公司研发能力提升建设项目，不产生直接的经济效益，但项目实施后可增强公司的综合研发实力，建立起更高的技术壁垒，加强技术复用，实现规模化扩张，进一步巩固和提高公司的核心竞争力。

“超募资金永久补充流动资金”项目将进一步优化公司财务结构和现金流状况，为公司主营业务相关的经营活动提供资金支持，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

上述募集资金投资项目均无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司前次募集资金投资项目无法单独核算收益，不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2020年8月24日，公司召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币165,000.00万元（含本数）。

2020年12月2日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币26,500万元超募资金永久补充流动资金。

2021年8月24日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起至公司2021年年度董事会召开之日（不超过12个月）止，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币100,000.00万元（含本数）。

2022年3月28日，公司召开了第一届董事会第三十次会议暨2021年年度董事会会议、第一届监事会第二十次会议暨2021年年度监事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过80,000万元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起至公司2022年度董事会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币80,000.00万元（含本数）。

2023年2月10日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 26,600 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已全部完成使用超募资金永久补充流动资金。

2023 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第七次会议暨 2022 年年度董事会会议、第二届监事会第六次会议暨 2022 年年度监事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内或至公司董事会/股东大会（视届时审批权限）审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理且未到期的具体情况详见下表：

单位：人民币万元

银行名称	产品类别	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	截至报告期末是否完成赎回	期限	收益
浦发银行	结构性存款	保本浮动利率	5,000.00	15/9/2023	15/12/2023	2.50%	否	90	5.56

截至 2023 年 9 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为 5,000.00 万元，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

九、前次募集资金使用的其他情况

为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，公司于 2021 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化”达到预定可使用状态时间延长至 2022 年 6 月。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日,公司前次募集资金尚未使用的金额为 9,994.30 万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),占前次募集资金净额的比例为 5.96%。上述募集资金尚未全部使用的原因是尚有部分项目款项未发生或尚未支付。

十一、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2023 年 9 月 30 日,公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告等已公开披露信息一致。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表

附表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额：1,677,953,077.52			已累计使用募集资金总额：1,637,475,100.75							
变更用途的募集资金总额：-			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：-			2020 年度：495,759,542.58							
			2021 年度：275,900,094.41							
			2022 年度：547,939,889.70							
			2023 前三季度：317,875,574.06							
投资项目			募集资金投资总额			截止 2023 年 9 月 30 日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资		
			投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	金额		
1	智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	150,000,000.00	150,000,000.00	150,116,828.98	150,000,000.00	150,000,000.00	150,116,828.98	116,828.98	2024 年
2	智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台	智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台	110,000,000.00	110,000,000.00	113,486,346.90	110,000,000.00	110,000,000.00	113,486,346.90	3,486,346.90	该项目已于 2022 年完成，并将节余募集资金(包括利息收入)转出并补充流动资金
3	智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	110,000,000.00	110,000,000.00	111,664,603.67	110,000,000.00	110,000,000.00	111,664,603.67	1,664,603.67	该项目已于 2022 年完成，并将节余募集资金(包括利息收入)转出并补充流动资金
4	智慧云平台系统级芯片定制平台	智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	120,000,000.00	120,000,000.00	118,967,830.18	120,000,000.00	120,000,000.00	118,967,830.18	-1,032,169.82	该项目已于 2022 年完成，并将节余募集资金(包括利息收

	的开发及产业化项目									入)转出并补充流动资金
5	研发中心升级项目	研发中心升级项目	300,000,000.00	300,000,000.00	308,327,829.51	300,000,000.00	300,000,000.00	308,327,829.51	8,327,829.51	该项目已于2022年完成,并将节余募集资金(包括利息收入)转出并补充流动资金
6	超募资金永久补充流动资金	超募资金永久补充流动资金	531,000,000.00	531,000,000.00	531,000,000.00	531,000,000.00	531,000,000.00	531,000,000.00	-	不适用
7	研发中心建设项目	研发中心建设项目	390,000,000.00	390,000,000.00	303,911,661.51	390,000,000.00	390,000,000.00	303,911,661.51	-86,088,338.49	2024年
合计			1,711,000,000.00	1,711,000,000.00	1,637,475,100.75	1,711,000,000.00	1,711,000,000.00	1,637,475,100.75	-73,524,899.25	-

注 1: 上表前次募集资金投资项目序号 1、序号 7 截至 2023 年 9 月 30 日均未达到预定可使用状态日期, 并按照项目实施计划正常进行中, 故截至 2023 年 9 月 30 日实际投资总额与承诺投资金额存在一定差异。

注 2: 上表前次募集资金投资项目序号 2、序号 3、序号 4、序号 5 项目已经于 2022 年完成并结项, 节余募集资金(包括利息收入)以转出并补充流动资金。

注 3: 募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金拟用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月		
1	智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
2	智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
3	智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
4	智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
5	研发中心升级项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
6	超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用